



中华人民共和国国家标准

GB/T 14113—2026

代替 GB/T 14113—1993

半导体集成电路封装术语

Terminology for packages of semiconductor integrated circuits

2026-09-28 发布

2027-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 通用术语 1

4 结构术语 4

5 技术、工艺术语..... 9

附录 A（资料性） 术语和定义修订及增删说明 17

参考文献 19

索引 20

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 14113—1993《半导体集成电路封装术语》，与 GB/T 14113—1993 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 更改了封装、盖板(管帽)、上框等 29 项术语和定义，补充了部分术语和定义的示意图，具体见附录 A(见第 3 章～第 5 章，1993 年版的第 3 章～第 5 章)；
- 增加了基板、线弧、银浆扩散等 21 项术语和定义，见附录 A(见第 3 章～第 5 章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国集成电路标准化技术委员会(SAC/TC 599)归口。

本文件起草单位：中国电子科技集团公司第十三研究所、中国电子技术标准化研究院、江苏长电科技股份有限公司、天水七四九电子有限公司、江苏中科智芯集成科技有限公司、江西万年芯微电子有限公司、西南交通大学、河北中瓷电子科技股份有限公司、北京智芯微电子科技有限公司、亿芯微半导体科技(深圳)有限公司、深圳市先进连接科技有限公司、深圳砺芯半导体有限责任公司、深圳市鸿芯微组科技有限公司、深圳市晨日科技股份有限公司、江苏东煦电子科技有限公司。

本文件主要起草人：王明阳、赵少康、彭博、李彩然、钟鑫、张秋、杨程、李习周、姚大平、艾育林、刘建涛、赵东亮、沈钦义、周永强、吴昊、朱小安、陈兴、钱雪行、陈超。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1993 年首次发布为 GB/T 14113—1993；
- 本次为第一次修订。

半导体集成电路封装术语

1 范围

本文件界定了半导体集成电路封装在生产制造、工程应用和产品交验等方面使用的基本术语。
本文件适用于与半导体集成电路封装相关的生产、科研、教学和贸易等方面的应用。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 通用术语

3.1

封装 package

半导体集成电路的全包封或部分包封体。

注：封装能提供机械保护、环境保护、外形尺寸、电气连接、散热通道。

3.2

底座 header

封装体中用来安装半导体芯片并已具备了芯片焊接(粘接)(3.11)、引线键合(3.10)和引出端(3.8)等功能封装结构的基体。

3.3

底板 base

在陶瓷或金属封装中,构成底座(3.2)的一种片状陶瓷或金属零件。

3.4

盖板(管帽) lid(cap/hat)

在陶瓷封装或金属底座上,采用金属、陶瓷或金属和玻璃制成片状或帽状结构,封接后对整个封装形成密封的一个零件。

3.5

上框 window frame

装在陶瓷封装或金属封装表面上的一个金属或陶瓷件。

注：在上框上能焊接一个用于密封的盖板(3.4)。

3.6

引线框架 leadframes

采用冲制或刻蚀工艺制造,具有一定几何图形和规定外形尺寸,提供陶瓷熔封或塑料封装引出线的一个或一组金属零件,其结构见图 1a)和图 1b)。